

プローブ回路基板の仕様

プローブ回路基板の仕様

	項目	仕様	
①	ガラス基材の厚み	t=0.5mm	任意に製作できます
②	配線・バンプの材質	Au	他の材質も製作できます
③	最小のバンプサイズ	□=7ミクロン×20ミクロン	その他の形状も製作できます
④	抵抗値 (バンプ～圧接の端子)	10Ω 以下	配線形状等を考慮して設計
⑤	最小ピッチ	8ミクロン	検査用電極パッドがストレート形状
⑥	RGBの最小合計幅 (下地配線幅の合計)	150ミクロン以下	L/S/L/S/L=30/30/30/30/30 単位ミクロン
⑦	累積ピッチ精度	±1.5ミクロン以内	
⑧	絶縁コート	バンプ近傍エリア	コローション対策(放電破壊対策)